### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





# (43) Internationales Veröffentlichungsdatum 4. Juli 2002 (04.07.2002)

## **PCT**

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/052634 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

-----

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE01/04903

H01L 21/66

(22) Internationales Anmeldedatum:

27. Dezember 2001 (27.12.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

100 65 380.4 27. Dezember 2000 (27.12.2000) DE

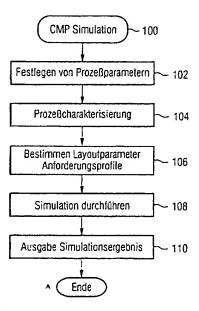
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Strasse 53, 81669 München (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DICKENSCHEID, Wolfgang [DE/DE]; Loebauer Strasse 3, 01099 Dresden (DE). MEYER, Frank [DE/DE]; Conradstrasse 20, 01097 Dresden (DE). DELAGE, Stéphanie [FR/DE]; Altersheimer Strasse 9a. 81545 München (DE). SPRINGER, Götz [DE/DE]; Weissenberger Strasse 9, 01324 Dresden (DE).
- (74) Anwalt: EPPING HERMANN & FISCHER; Ridlestrasse 55, 80339 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR CHARACTERISING AND SIMULATING A CHEMICAL-MECHANICAL POLISHING PROCESS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR CHARAKTERISIERUNG UND SIMULATION EINES CHEMISCH-MECHANISCHEN POLIER-PROZESSES



- 100 CMP SIMULATION
- 102 DETERMINATION OF PROCESS PARAMETERS
- 04 PROCESS CHARACTERISATION
- 106 DETERMINATION OF LAYOUT PARAMETERS REQUIREMENT PROFILE
- 108 CARRY OUT SIMULATION
- 110 OUTPUT SIMULATION RESULT
- A END

- (57) Abstract: The invention relates to a method for characterising and simulating a CMP process, according to which a substrate to be polished, in particular a semiconductor wafer is pressed onto a polishing cloth and rotated in relation to the latter for a specified polishing period. Said method comprises the following steps: a) determination of a set of process parameters, in particular of the contact force and the relative rotational speed of the substrate and the polishing cloth; b) provision and characterisation of a test substrate comprising test patterns with different structural thicknesses for the specified process parameters; c) determination of a set of model parameters for simulating the CMP process from the results of the characterisation of the test substrate; d) determination of layout parameters of the substrate to be polished; e) determination of a requirement profile relative to the CMP processes for determining the polishing period necessary to fulfil the requirement profile. The invention also relates to a method for operating a test device for semi-conductor components.
- (57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Charakterisierung und Simulation eines CMP-Prozesses, bei dem ein zu polierendes Substrat, insbesondere ein Halbleiterwafer, auf ein Poliertuch gedrückt und relativ zu diesem für eine bestimmte Polierzeit rotiert wird, umfaßt die Verfahrensschritte: a) Festlegen eines Satzes von Prozeßparametern, insbesondere von Andruckkraft und relativer Rotationsgeschwindigkeit von Substrat und Poliertuch, b) Bereitstellen und Charakterisieren eines Testsubstrats mit Testmustern mit unterschiedlichen Strukturdichten bei den festgelegten Prozeßparametern; c) Bestimmen eines Satzes von Modellparametern zur Simulation des CMP-Prozesses aus den Ergebnissen der Charakterisierung des Testsubstrats; d) Bestimmen von Layoutparametern des zu polierendes Substrats; e) Festlegen eines Anforderungsprofils an das CMP-Prozeßergebnis für das zu polierende Substrat; und f) Simulieren des CMP-Prozesses zur Bestimmung der zur Erfüllung des Anforderungsprofils erforderlichen Polierzeit. Verfahren zum Betrieb einer Testvorrichtung für Halbleiterbauelemente.

WO 02/052634 A2

### Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # <u>P2000, Q36 (</u>

Applic. #

Applicant: W. Didousdelid

Lerner and Greenberg, P.A. A No. Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480

Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

# PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P2000,0361 WO N	WEITERES  slehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monal/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr		
PCT/DE 01/04903	27/12/2001	27/12/2000		
INFINEON TECHNOLOGIES AG				
Oleser Internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	le von der Internationalen Rechercher ernationalen Büro übermittelt,	nbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß		
Dieser Internationale Recherchenbericht umfa   Darüber hinaus liegt Ihm jev		lätter. genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
1. Grundlage des Berichts				
	rnationale Hecherche auf der Grundla Jereicht wurde, sofern unter diesem Pu	ge der internationalen Anmeldung In der Sprache unkt nichts anderes angegeben ist.		
Die Internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen		
Recherche auf der Grundlage des S	n Anmeidung offenbarten Nucleotld- Sequenzprotokolls durchgefühn worde Idung In Schriflicher Form enthalten Is			
	onalen Anmeldung in computeriesbare			
bei der Behörde nachträglic	h in schrittlicher Form eingereicht wor	den ist.		
bei der Behörde nachträglic	h in computerlesbarer Form eingereld	ht worden ist.		
Die Erklärung, daß das naci Internationalen Anmeldung	nträglich eingereichte schrittliche Sequ Im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurd	uenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der de vorgelegt.		
Die Erklärung, daß die in co wurde vorgelegt.	mputeriesbarer Form erfaßten Informa	ationen dem schriftlichen Sequenzprotokoli entsprechen,		
2. Bestimmte Ansprüche hal	oen sich als nicht recherchierbar er	wlesen (siene Feld I).		
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).			
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	dung			
wird der vom Anmelder eing	pereichte Wortlaut genehmigt.			
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung				
wurde der Wortlaut nach Re	e innerhalb eines Monats nach dem Di	nen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der atum der Absendung dieses Internationalen		
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen	lst mit der Zusammenfassung zu veröf			
wie vom Anmelder vorgesch		keine der Abb.		
	In Abbildung vorg schlagen hat.			
well diese Abbildung die Er	indung besserk innzeichnet.			

5

#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/DE 01/04903

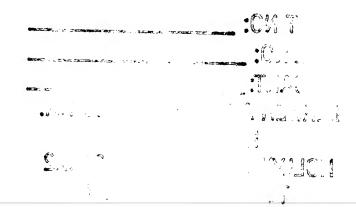
A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L21/66 B24B37/04 B24B49/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK 8. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) B24B H01L Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiele fallen Während der internationaten Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle Betr. Anspruch Nr. X US 6 057 068 A (BURKE PETER A ET AL) 1,2,17 2. Mai 2000 (2000-05-02) Spalte 6, Zeile 51 -Spalte 7, Zeile 29 A US 6 159 075 A (ZHANG LIMING) 1,17 12. Dezember 2000 (2000-12-12) Zusammenfassung Siehe Anhang Patentiamille Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen \*T\* Spälere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der \* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondam nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ähr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist \*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffemlicht worden ist 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Täligkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie verorentilerung von descheren Sadeutung, die Bearsprüchte Einmud kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Veröffeung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist O° Veröffenllichung, die sich auf eine m\u00fcndliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussteltung oder andere Ma\u00dfnahmen bezicht
 P° Ver\u00f6flentlichung, die vor dem internationatien Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Priorit\u00e4tsdaum ver\u00f6flentlicht worden ist \*&\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche 23. Januar 2003 30/01/2003 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensleter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Eschbach, D Fax: (+31-70) 340-3018

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Palentlamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 01/04903

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US	6057068	A	02-05-2000	KEINE		
US	6159075	A	12-12-2000	CN EP WO	1340210 T 1138071 A1 0127990 A1	13-03-2002 04-10-2001 19-04-2001



DOCKET NO: P2000, 0361
SERIAL NO:
APPLICANT: W. Dickenscheid et al
LERNER AND GREENBERG P.A.
P.O. BOX 2480
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
TEL. (954) 925-1100